

需要定制解决方案吗？

联系我们



# 焊料预置引脚技术

## Solder Bearing Lead

ENNOVI的SBL技术通过一步操作，确保焊点完美一致，避免了传统焊接中常见的偏差、返工和不良品，从而实现100%的可焊性和卓越的焊点一致性。

# ENNOVI™

恶劣环境下的卓越可靠性



我们的预成型药芯焊片经过精心设计，能够承受热应力、振动和各类环境挑战，每次都能形成完美的机械和电气焊点。

带爪形边缘夹的完美焊点



预涂焊料和助焊剂确保精确、可重复的接头，不产生任何偏差，并消除冷焊、空洞和高昂的返工成本。

一步组装以提高效率



将焊接过程简化为一个步骤，消除了对焊锡膏、焊锡浸泡或二次助焊剂的需求。

应用领域

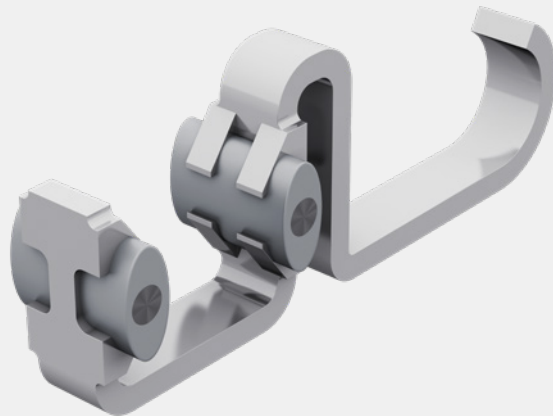
混合电路、子组件堆栈、控制单元、传感器、屏蔽组件、引线框架、印刷电路板（PCB）和柔性电路中的互连和装配。

目标市场

+ 航空航天  
+ 汽车制造  
+ 工业生产  
+ 医疗健康  
+ 电信行业

### 焊料预置引脚技术

- + 实现一步装配：只需将引脚简单地压入基板上并进行回流焊。
- + 具有100%焊接性：独特的ENNOVI“爪形”引脚设计可使焊料与导体焊盘直接接触，几乎不存在未焊接的接点。
- + 提供简便的自动化装配：仅需一名操作员或一台机器通过一道工序即可完成从引脚到基板的整个装配过程。
- + 适应安全的局部加热：ENNOVI引脚可以在不将电路板温度升高至回流焊点的情况下与焊盘结合。
- + 极大地降低了损坏预装配件的风险。
- + 支持连续的回焊
- + 消除热失配和振动故障
- + 具有多样性：适用多种具有不同熔点的各类焊料，并可与任何类型的助焊剂配合使用，在堆焊和复合焊接操作中具有极大的灵活性。
- + 实现快速简便的转换：无需大量的资金投入或专业的劳动技能。
- + 显著降低产品成本：为混合电路和PCB电路连接引脚提供快速可靠的解决方案——提升产品质量，降低整体成本。



### 产品类型

双排直插封装

单排直插封装

表面贴装封装

短接夹封装

双列互连

通孔互连

特殊互连

